

主催：岩手大学分子接合技術研究センター  
共催：i-SB事業化プラットフォーム  
(運営主体：岩手大学、岩手県、岩手県工業技術センター、いわて産業振興センター)  
後援：INSポリマー研究会、東北ポリマー懇話会

日時：

2024年

6月28日(金)

13:00-17:15

オンライン (Zoom)

## 第2回

# 次世代高速通信に対応した 高周波基板材料に関するセミナー

岩手大学分子接合技術研究センターは、i-SB事業化プラットフォームの中核組織として、分子接合技術(i-SB法)と機能樹脂設計技術をものづくり分野に幅広く展開し、新たなプロセスや製品のイノベーションを創出することを目指しています。

このたび、当センターでは、Beyond 5Gに向けた高周波基板材料に関するセミナーを開催します。

### ◆参加費：10,000円

(消費税込・資料付き)

### ◆申込：

下記URLまたはQRコードを読み込んで  
お申し込み下さい。

<https://forms.gle/3toMzLVRz9ezNcnR7>

申込期限

6月21日(金)



### ◆プログラム：

1.

#### 半導体関連基板の技術動向

(60分)

FICT株式会社 経営企画本部 本部長付 杉本 薫 氏

2.

#### 高速通信向け基板材料の開発

(60分)

太陽インキ製造株式会社 技術開発センター  
課長 仲田 和貴 氏

3.

#### 次世代パッケージ向け高信頼性・ 低誘電基板材料の開発

(60分)

住友ベークライト株式会社 情報通信材料研究所  
研究部長 小俣 浩 氏

4.

#### 日本化薬における低誘電樹脂の開発

(60分)

日本化薬株式会社 ファインケミカルズ研究所  
研究員 本多 理沙 氏

•お申し込み受付後、請求書 (PDFファイル)  
を発行し、メールでお送りします。  
請求書に記載されている振込先に、参加費  
のお振り込みをお願いします。

•参加者には、セミナー前日までに、ミーティング  
リンクを送付します。

問い合わせ先

岩手大学 分子接合技術研究センター事務局 (岩手大学 研究・地域連携課)

✉ [isb-office@iwate-u.ac.jp](mailto:isb-office@iwate-u.ac.jp)  <https://www.iwate-u.ac.jp/academics/facility/mbt.html>